

halsey.wu@amtdgroup.com

新闻更新

2020 年 6 月 24 日

亚马逊推出 Honeycode，无需编码即可构建应用程序

云/IaaS

亚马逊推出 Honeycode 新服务，可以让客户在零编码知识基础下快速建立应用程序。Honeycode 包含可视化界面，可用于构建多样化需求的应用程序，例如项目管理应用程序或任务跟踪应用程序。（来源：[Amazon](#)）

亚马逊

2020 年 6 月 24 日

三大运营商降低 5G 套餐门槛，低至人民币 69 元

5G

三大运营商纷纷下调 5G 套餐价格，其中中国移动折扣力度最大，目前最低的 5G 套餐只要 69 元。随着 5G 套餐用户规模越来越大，中国市场或迎来第一波 5G 消费潮，这也会刺激更多的开发者推出 5G 应用，5G 产业链会加速成熟。（来源：[Aastock](#)）

电信运营商

2020 年 6 月 23 日

英伟达与奔驰将深度合作研发智能汽车，首款产品 2024 年推出

AI/自动驾驶

梅赛德斯-奔驰与英伟达将携手打造革命性的车载计算系统和 AI 计算基础架构。自 2024 年起，梅赛德斯-奔驰将在其下一代车型中推出该配置，赋予其可升级的自动驾驶功能。（来源：[Nvidia](#)）

英伟达

2020 年 6 月 22 日

腾讯云将发星海首款四路服务器，提供高密度计算和存储能力

云/IaaS

腾讯云将推出星海首款四路服务器。该服务器由腾讯云自主设计，并与浪潮联合研发，将搭载四颗腾讯云与英特尔合作深度定制的最新一代 Cooper Lake CPU，将云服务器实例密度提升了 116%，能够满足用户在超大规模高并发应用场景下对超大规格云服务器实例的需求。（来源：[TencentCloud](#)）

腾讯/浪潮

2020 年 6 月 22 日

台积电南科十八厂 5nm 产能拉升至单月 6 万片

半导体

随着采用 5nm 制程的高通骁龙 875 手机芯片和 X60 5G 基带正式在台积电南科十八厂投片，目前，台积电已将南科十八厂 5nm 产能快速拉升至单月逼近 6 万片，5nm 产能较上月大增近 6000 片。以投片时程估算，预计高通这两款芯片将于 9 月交货。（来源：[Techweb](#)）

台积电

2020 年 6 月 19 日

百度宣布加大新基建投入，2030 年百度智能云服务器超过 500 万台

云/IaaS

百度宣布，未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入。预计到 2030 年，百度智能云服务器台数超过 500 万台，为中国智能经济发展提供强有力的支撑。百度还宣布未来 5 年预计培养 AI 人才 500 万。（来源：[Baidu](#)）

百度

2020 年 6 月 19 日

微软收购数据模型提供商 ADRM

云/AI

微软/ADRM

微软收购了一家提供大规模的行业特定数据模型的公司——ADRM 软件，其数据模型覆盖了通信、金融服务和医疗保健等多个行业。微软将把 ADRM 的数据模型与 Azure 存储和计算相结合，以创建智能数据库。（来源：[Microsoft](#)）

2020 年 6 月 19 日

台积电 6 月开始生产 A14 芯片，以用于下一代 iPhone

半导体

台积电

台积电在 6 月开始生产 A14 芯片和骁龙 X60 基带，以用于计划在 2020 年下半年推出的 iPhone。骁龙 X60 是世界上首个支持聚合全部主要频段及其组合的 5G 调制解调器，包括毫米波和 6GHz 以下的 FDD 和 TDD 频段。（来源：[Digitimes](#)）

2020 年 6 月 18 日

荣耀路由 3 在 618 网购节销量第一

设备

华为

6.18 购物节，荣耀路由系列产品开售时便获得了全网 45 秒销量破万的好成绩。数字系列旗舰机荣耀路由 3 在京东、天猫、苏宁平台销量排名第一。荣耀路由 3 是该品牌首款 Wi-Fi 6+ 路由器，售价仅为人民币 199 元。（来源：[Honor](#)）

2020 年 6 月 17 日

高通宣布推出全球首款支持 5G 和 AI 的机器人平台 RB5

半导体

高通

高通宣布推出全球首个支持 5G 和 AI（人工智能）的机器人平台 RB5。基于现已被机器人和无人机产品广泛采用的 Qualcomm® 机器人 RB3 平台的成功，Qualcomm 机器人 RB5 平台提供了丰富的硬件、软件和开发工具组合。该平台采用了专为机器人应用而设计的 Qualcomm QRB5165 处理器。QRB5165 拥有强大的异构计算架构，能够运行复杂的人工智能和深度学习任务。（来源：[Qualcomm](#)）

2020 年 6 月 17 日

2020 年第一季度全球智能手表出货量达 1,430 万，同比增长 12%

智能手表

全球第一季度智能手表出货量为 1,430 万，同比增幅 12%。苹果以出货量为 520 万居首，排名第二的是华为，出货量为 210 万。中国在 2020 年第一季度的出货量同比增长 66%，随着全国 eSIM 覆盖范围扩大，中国市场将成为 2020 年智能手表增长的主要来源。（来源：[Canalys](#)）

2020 年 6 月 17 日

App Store 去年全球销售额 5,190 亿美元

半导体

苹果

苹果公司宣布，App Store 去年创下了 5,190 亿美元的销售额。Analysis Group 研究表明，跟商品及实体服务有关的销售额最大，达到 4,130 亿美元，涉及网购、出行、送餐等多个领域。从地区来看，中国以 2,460 亿美元的销售额排名第一，排在第二名的美国市场为 1,380 亿美元。（来源：[EEWorld](#)）

2020 年 6 月 16 日

高通发布全新 5G 处理器骁龙 690

半导体

高通

高通发布了骁龙 6 系列首款支持 5G 的处理器——骁龙 690。该处理器采用 8nm 工艺，搭配 X51 调制解调器，被认为是骁龙 675 的继任者。由 690 芯片植入的智能手机中售价将更低，这将促进 5G 终端的普及。搭载骁龙 690 的设备预计将在 2020 年下半年上市。（来源：[Qualcomm](#)）

2020 年 6 月 15 日

SAS 与微软就云服务达成合作以推进数据分析和人工智能

云/AI

微软/SAS

微软和全球最大私营软件公司之一 SAS 宣布双方就技术范围和市场战略方面达成合作，以扩展双方业务，从数字转型计划中释放关键价值。作为合作的一部分，微软会成为 SAS 云服务的首选云平台提供商，SAS 的分析产品和行业解决方案随后也会被转移至 Azure 平台。这次合作基于 SAS 与微软云端解决方案的整合，当中包括 Azure、Dynamic 365、Microsoft 365 及 Power Platform 等。（来源：[Microsoft](#)）

2020 年 6 月 15 日

Unity 和腾讯云合作推出 Unity 游戏云

云

腾讯/Unity

实时 3D 内容创作平台 Unity 和腾讯云合作推出了 Unity 游戏云（Unity Connected Games），用以简化游戏服务器端开发，降低多人联网游戏的创作门槛。（来源：[Pandaily](#)）

2020 年 6 月 15 日

诺基亚与博通合作开发 5G 芯片

半导体

诺基亚/博通

诺基亚表示，正与博通合作开发先进半导体技术，包括新的定制处理器，将被整合至诺基亚“由 ReefShark 驱动的 5G”组合中。此次合作进一步扩大了诺基亚 ReefShark 芯片组适用于 5G 解决方案的范围，并将改善 5G 网络的系统性能和能源消耗。（来源：[Nokia](#)）

2020 年 6 月 10 日

英特尔正式发布 Lakefield 系列处理器，采用 3D 封装技术

半导体

英特尔

英特尔推出了采用英特尔® 混合技术的英特尔® 酷睿™ 处理器，其代号为“Lakefield”。Lakefield 处理器利用了英特尔的 Foveros 3D 封装技术和混合 CPU 架构，可实现出色的功耗和性能可扩展性。采用英特尔混合技术的英特尔酷睿 i5 和 i3 处理器配备了 10 纳米 Sunny Cove 内核，可支持运行需求更高的工作负载和前台应用，而四个低功耗 Tremont 内核可在功耗和性能优化之间取得平衡，以支持后台任务。（来源：[Intel](#)）

2020 年 6 月 10 日

苹果或正开发可折叠 iPhone，无刘海、两块屏拼接

智能手机

苹果

据透露，苹果正在开发一款可折叠的 iPhone 原型机，特点是将两个独立的显示面板通过铰链连接，没有“刘海”，但在显示屏外侧有一个“小小的额头”，用于 Face ID。此外，报道称，全球领先的砷化镓微波积体电路（GaAs MMIC）晶圆代工公司稳懋半导体（Win Semiconductors）从 6 月开始就在密集生产，为苹果加工新 iPhone 所需的 VCSEL 芯片，比如 Face ID 模块的 3D 传感器、背部摄像头的 ToF 等。（来源：[Patently Apple](#)）

重要声明

分析师声明

我们，李小明和吴雨鹤在此证明，（i）本市场评论中表述的任何观点均精确地反映了我们对有关市场、公司及其证券的个人看法；（ii）我们所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接与我们在本市场评论中所表达的具体建议或观点相联系，也不与尚乘环球市场有限公司的交易相联系。

在本市场评论发布当日，李小明拥有评论中提及到与Amazon有关的财务权益。

尚乘环球市场有限公司

地址：香港中环干诺道中 41 号盈置大厦 23 楼 - 25 楼

电话：(852) 3163-3288 传真：(852) 3163-3289

一般性声明

市场评论由尚乘环球市场有限公司（“尚乘”）编制，仅供尚乘的客户参考使用，尚乘不会因接收人收到本市场评论而视其为客户。

本市场评论仅提供一般信息，并非作为或被视为出售或购买或认购证券的邀请。本评论内提到的证券可能在某些地区不能出售。本评论（i）不提供构成个人意见或建议，包括但不限于会计、法律或税务咨询或投资建议；或（ii）不考虑特定客户的特定需求，投资目标和财务状况。尚乘不作为顾问，也不会对任何财务或其他后果承担任何受托责任或义务。本市场评论不应被视为替代客户行使的判断。客户应考虑本市场评论中的任何信息，意见或建议是否适合其特定情况，并酌情寻求法律或专业意见。

本市场评论所载资料的来源被认为是可靠的，但尚乘不保证其完整性或准确性，除非有尚乘和/或其附属公司的任何披露。对于本市场评论提及的任何证券，其价值、价格及其回报可能波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。未来的收益不能保证，本金可能会损失。

市场评论所载的资料，估计，观点，预测和其他信息均反映发布评论当日的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改。尚乘及其附属公司或其任何董事或雇员（“尚乘集团”）并不明示或暗示地表示或保证市场评论中包含的信息正确、准确或完整。尚乘集团对使用或依据市场评论及内容不承担任何责任或义务。

本市场评论可能包含来自第三方的信息，例如信用评级机构的信用评级。除第三方事先书面同意，禁止以任何方式复制和再分发任何形式的第三方内容。第三方内容提供者不保证任何信息的及时性、完整性、准确性或可用性。第三方不对任何错误、遗漏或使用这些内容所获得的结果负责。第三方内容提供商不提供任何直接或间接的保证，包括但不限于任何用于特定用途适用性或适销性的保证。第三方内容提供商不对使用其内容造成的任何直接、间接、偶然、示范、补偿、惩罚、特殊或间接的损害、费用、开支、法律费用或损失（包括收入或利润损失和机会成本）负责。信用评级是意见声明，不是购买、持有或出售证券的行为或建议声明。第三方并没有强调所涉及的证券适用于投资目的，也不应该作为投资建议。

在有关的适用法律和/或法规允许的范围内：（i）尚乘和/或其董事和雇员，可以作为被代理人或代理人，对本评论所涉及的证券或其他相关金融工具，进行买卖、建仓或平仓（ii）尚乘可以参与或投资市场评论中提及的证券发行人融资交易，或提供其他服务或承销；（iii）尚乘可以对在市场评论中提到的发行人提供做市；（iv）尚乘可能曾担任本评论提及证券公开发行的经办人或联合经办人，或者可能会在本评论中提及证券的发售过程中提供暂时做市，或可能在过去 12 个月内提供其他投资银行服务。

尚乘通过其合规政策和程序（如信息隔离墙和员工交易监控）来控制信息流和管理利益冲突。

本市场评论所载内容的版权为尚乘所有，未经尚乘环球市场有限公司事先书面授权，本市场评论的任何部分均不得以任何形式转载或以任何形式转载给任何人。
